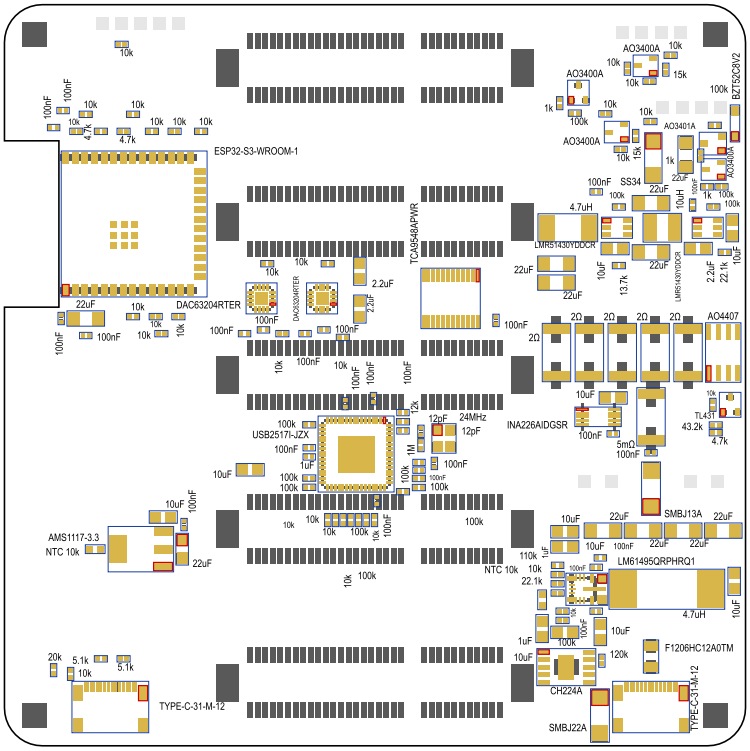
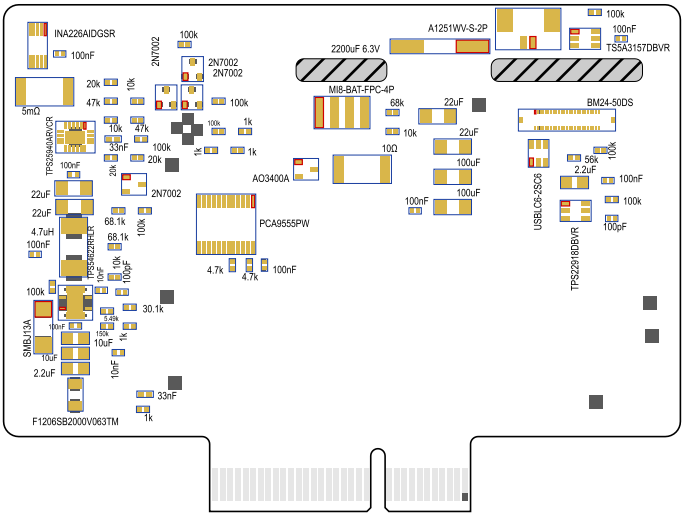
PhoneRail R2 焊接图 • 器件值 • 1:1（底板 BASE-PCB + 刀片 BLADE-PCB 旧版）

两块都是【背面 / 器件面，左右镜像】= 把板子翻过来看到的样子。红框 = 封装 1 脚（IC 定位；二极管多为负极、电解/钽电容为正极）。打印「实际大小 100%」。

底板 98 × 98（背面）



刀片 89.5 × 67（背面，金手指朝下）



80 mm（打出来量，应为 80.0）

正面器件（不在图上）：

底板：C2 / C3 = 470uF 25V 电解（注意极性） J26 / J27 = 2510-4A 风扇座 J33 = 1×5P 2.54 排针 J34~J38 = PCIE-64P11L 插槽

刀片：J1 = 金手指（不焊） K1~K4 = 侧键焊盘（不焊）

字号：大多 1.0 mm，挤的地方 0.85 / 0.7 mm。只写了器件值；看位号请开 EDA。

文件：.claude/r2/print/value_1to1.pdf（print_value.py 生成）